

TSV-Solution Forum プログラム

- 13:30 受付開始
- 14:00-14:10 御挨拶 (株)富士通九州システムエンジニアリング PLMソリューション統括部部長 夕田 和弘
- 14:10-15:20 「TSV-Solutions の LIVE デモ紹介と今後のロードマップ」
株式会社テクノスター 代表取締役社長 立石 勝 殿
- 15:20-15:35 休憩
- 15:35-16:25 「FQS が提供する新たな樹脂流動解析ソリューション TSV-Solution と Moldflow の
コラボレーション活用事例のご紹介」
(株)富士通九州システムエンジニアリング PLMソリューション統括部 佐々木 学
- 16:25-17:15 「富士通が提供する機械・装置系 3次元 CAD ICAD/SX と TSV-Solution の
活用事例のご紹介」
(株)富士通九州システムエンジニアリング PLMソリューション統括部 深町 幸士朗

* スケジュールは予告なく変更することがあります。

セミナー参加申込方法

本セミナーは、全て予約制となっております。参加を希望される場合は、大変お手数ではございますが、必要事項を記載の上、メールにてお申し込みください。誠に勝手ながら、電話や FAX での受付は行っておりませんので、予めご了承下さい。

参加申込アドレス

fqs-de-cae@ml.jp.fujitsu.com

【申込要項】以下の必要事項をご記入の上、お申し込みください。

受付後、受講証をお送りいたします。印刷して当日会場受付にご提示ください。

1. 御社名
2. 部署名
3. 連絡先住所((郵便番号と住所))
4. 連絡先電話番号
5. 連絡先メールアドレス
6. 参加者名

会場の都合上、1社最大3名様までのエントリーとさせていただきます。

なお、申込受付は先着順となります。

会場定員超過の場合、ご希望に添えない場合がございますので、お早めにお申し込み下さい。